

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

### 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详见附件《参会人员名单》
时间	2024年8月28日、2024年8月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生；副总经理、财务总监金良凯先生； 副总经理、董事会秘书李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.2024年上半年经营情况介绍？</b></p> <p>从市场方面，2024年上半年得益于整个集成电路产业景气度的回暖、部分客户所处领域的景气度回升，公司在原有客户的产品份额上进一步提升，同时新客户尤其是台系大客户的拓展顺利，公司稼动率整体呈稳定回升趋势。上半年公司实现营收 16.3 亿元，同比增长超过 65%。随着公司营业收入的增长，规模效应进一步体现，整体毛利率达到 18%，同比增加 5.83 个百分点，公司上半年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润超 1,200 万元，同比增加超过 9,000 万。</p> <p>在新产品布局方面，公司在晶圆级封装和汽车电子等领域的产品线持续丰富，重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力已经形成，在品质/交付等方面优势明显，对于先进制程特别是 SoC 类芯片领域的客户具备较强吸引力。新产品线如模组和汽车电子的部分产品顺利导入量产，公司将伴随客户一起成长。</p> <p>在研发方面，公司持续加大研发投入，积极布局 Fan-</p>

out/2.5D 等先进封装领域，2024 年上半年，Fan-out 已经初步通线，处于量产前的导入阶段；公司在 2.5D 领域持续布局，核心站别的设备已经 move in，正属于安装调试的过程中，先进封装的整体进度按计划稳步推进。

展望下半年，随着集成电路行业整体去库存周期进入尾声，下游客户需求将得到一定修复，公司的产品线持续丰富，预计下半年营收将保持向上的态势。公司将坚持中高端先进封装的定位和大客户战略，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。

## **2.公司上半年毛利率提升明显的原因是什么？公司如何平衡折旧与产品结构升级的关系？未来毛利率的变化情况？**

2024 年上半年公司营收规模快速提升，规模效应逐渐体现，对毛利率有正向的提升作用。同时，随着公司稼动率持续保持高位，优先承接毛利率较好的产品，公司产品结构也有一定变化，FC 类产品占比提升，综合导致公司上半年毛利提升较大。

长期来看，影响毛利率的核心因素包括价格、稼动率、产品结构以及新增投资产生的营收增量与新增折旧的动态平衡关系。从目前来看，价格已经触底；公司稼动率持续处于较高水平；来自晶圆级封装及 FC 类产品贡献营收将持续增加，产品结构持续优化；新增投资产能爬坡顺利，以上几个因素在未来应该都会对毛利率形成正向的影响。

## **3.公司先进封装的节奏及客户导入情况？**

公司持续和客户保持沟通，正在进行量产前的项目研发，2.5D 的设备已经 move in，处在通线前期的设备安装调试阶段，公司正在对接国内客户的需求，随着工艺和量产能力的提升，相信能够吸引更多客户。

## **4.公司下游应用领域的需求增长情况及景气度展望？**

公司营收主要来自消费电子、工规、车规等领域。具体

来说，IoT 类客户占比 50%~60%左右，PA 类占比 15%左右，安防领域占比 15%，运算领域和汽车电子领域的营收绝对占比较低，但增速较快。从公司的观察看，下游 IoT 客户增量较为明显，目前需求还比较乐观；PA 领域二季度相对平淡，预计下半年会有所回暖。

#### **5.公司如何看待下半年 Bumping 的竞争格局？**

随着制程越来越先进，选择 FC 和 Fan-out 的客户将越来越多，相关需求会持续上升，公司 Bumping 的产量也在持续上升。

#### **6.公司目前按封装形式拆分的收入结构有大变化吗？**

2024 年上半年公司按照“系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、晶圆级封测产品（Bumping 及 WLP）、微机电系统传感器（MEMS）”5 大类别进行划分，各类产品营收规模均有较大提升，FC 类产品占比有所提升。

#### **7.公司目前稼动率相对饱满，在考虑优化产品结构吗？**

公司专注于中高端封测，先进封装的营收占比会持续提升；在维持现有稼动率的同时，公司坚持做有门槛的客户和产品，避免陷入低价内卷。

#### **8.公司选购设备和材料时候的具体考量是什么？是否有在推进国产替代？**

公司在采购材料和设备时会优先考虑是否满足公司技术要求以及可靠性；其次会考虑供应链安全，寻找多家供应商。

公司坚定不移支持国产替代，持续推进国产设备和材料的导入。

#### **9.今年的折旧情况及后续的折旧趋势展望？**

从全年来看，公司今年全年的折旧摊销大约 8 亿，明年折旧的绝对金额预计仍会上涨，但相信随着营收规模的增长

	<p>会有所摊薄。</p> <p><b>10.上半年公司原料端基板和引线框架价格变动对公司利润的影响有多少，下半年库存余额是否会有跌价风险？</b></p> <p>2024年上半年公司在原材料方面主要通过和供应商持续议价以及引入国产优质供应商来实现成本降低。公司库存主要为原材料，由于公司的基础材料大多为客户定制的产品，因此我们会根据客户约定的使用期限和回购条款综合评估材料价值，公司已经充分计提了存货跌价准备。</p>
附件清单（如有）	《参会人员名单》
日期	2024年8月28日和2024年8月29日